

ファイナルレポート

国際コンポーネント・システム・アプリケーション専門見本市

2026 年 7 月 1 日～3 日

中国・上海新国際見本市会場

2026 年 7 月 3 日

electronica Shanghai 2026 は、エレクトロニクス産業の革新と発展を牽引し
盛況裡に閉幕

Summary

- 2,065 社が出展、業界関係社
79,026 名が来場
- 120,000 平方メートルに及ぶ総展
示面積
- 15 本のフォーラムを併催し、多数
の業界有識者が最新トレンドにつ
いて議論



Facts & Data

会 期	2026 年 7 月 1 日(水)～3 日(金) 9 時～17 時(最終日のみ 16 時まで)
会 場	中国・上海新国際見本市会場
主 催	Messe München GmbH – メッセ・ミュンヘン Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd. – メッセ・ミュンヘン上海
規 模	120,000 m ² (2025 年: 100,000 m ²)
出 展 企 業	2,065 社 (2025 年: 1,794 社)
来 場 者 総 数	79,026 人 (2025 年: 66,960 人)
主 な 出 展 品 と 出 展 技 術	<electronica China> 半導体全般、パワー半導体部品、エンベデッド・システム、センサー、MEMS、リ レー、スイッチ、配線技術、受動部品、モーター、駆動部、ケーブル、アセンブリ・サ ブシステム、マイクロ波技術、ディスプレイ、パワーサプライ
出 展 日 本 企 業 (現法出展など含む)	(株)アジアンエクスプレス、オムロン(株)、兼松ケミカル(株)、(株)キーエンス、菊水電子工 業(株)、ケル(株)、コアスタッフ(株)、コアスタッフ(株)、サンエツ金属(株)、サンコール株、シ ヤチハタ株、進工業(株)、住友電装(株)、第一精工(株)、太陽社電気(株)、太陽誘電(株)、 TDK(株)、(株)東芝、ニチコン(株)、(株)ニューテックス、日本オートマチックマシン(株)、日本 高純度化学(株)、パナソニックインタストリー(株)、(株)原田伸銅所、日置電機(株)、(株)日立 ハイテクアナリシス、ヒロセ電機(株)、富士端子工業(株)、(株)マルニックス、(株)村田製作 所、RAMXEED(株)、ローム(株)、ルビコン(株)ほか(50 音順)
専 用 U R L	www.electronicachina.com.cn/en (英語)

3 日間にわたって最先端技術と活発な交流が繰り広げられた electronica Shanghai 2026 は、上海新国際見本市会場(SNIEC)において盛況のうちに閉幕した。



今年の見本市には、国内外の著名な業界ブランド 2,065 社が参加し、展示面積が 12 万平方メートルにも及ぶ中、79,026 人の業界関係者が来場した。

技術革新と産業構造の変革が進む中、本見本市では、半導体、センサー、電源管理、コネクティビティ技術など、主要分野における最新の技術成果を体系的かつ包括的に紹介し、エレクトロニクス産業のエコシステム全体を俯瞰する視点を提示した。

メッセ・ミュンヘン CEO のラインハルト・ファイファーは、「出展者各位には積極的なご参画を、

来場者の皆様には熱心なご参加を、そして何よりもパートナーの皆様には長年にわたってご支援を賜り、心から感謝申しあげる。皆様からの信頼こそが、エレクトロニクス産業における、この年次的一大イベントを可能にしている。electronica Shanghai 2026 は単なる見本市ではなく、業界全体における深い交流、協働、そしてイノベーションを通年で促進するプラットフォームとして機能している。今後も、デジタル化と持続可能な発展を推進しつつ、新たな成長機会の創出に向けて共に歩んでいきたい」と述べている。

メッセ・ミュンヘン上海の最高財務責任者(CFO)兼副総経理であるヤン・ローデは、「盛夏の活気に満ちたこの時期にあたり、electronica Shanghai 2026 を代表して、来場者各位、出展者各位、業界関係者の皆様、そして長年にわたってエレクトロニクス産業を支援してくださっている各界の皆様へ、心から御礼申しあげる。私たちは、専門性への献身とオープンな協働の精神を今後も堅持し、展示会サービスのさらなる向上に努めるとともに、エレクトロニクス産業にとって、より価値ある、より活力に満ちた国際交流プラットフォームの構築を進めていきたい」と述べている。

今年の見本市で提示された知見は、極めて精緻であり、かつ先見性に富むものである。本イベントは産業動向を的確に捉え、スマート新エネルギー車、人工知能(AI)、身体性を備えた知能、AI データセンター、グリーン蓄エネルギー(再生可能エネルギーを蓄えて活用する技術)、インダストリー 4.0、6G 通信、低空域経済(ドローンや空飛ぶクルマなど、地上から高度約 1,000m の空域を活用する新産業群)、さらに IoT (モノのインターネット)、およびスマートウェアラブルの、計 10 の主要トレンド分野に焦点を当てている。本見本市は、産業チェーン全体に対して明確かつ堅固な技術ロードマップを提示し、激動のこの変革期において、業界が事業機会を確実に捉え、将来の成長に向けた確かな道筋を見出せるよう支援することを目的としている。

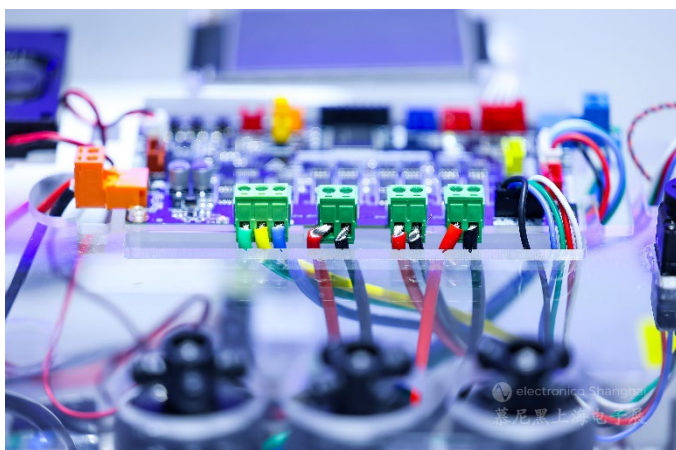
パラダイムシフト:自動車エレクトロニクス分野で進展する構造的なスマート革命

市場規模の急拡大、技術的進路の再構築、政策効果の顕在化という 3 つの要因が相乗効果を生み、膨大なビジネスチャンスが生まれている。本見本市の主要ハイライトである自動車向けエレクトロニクス・エリアでは、Infineon Technologies 社、STMicroelectronics 社、onsemi 社、NOVOSENSE 社、GigaDevice 社、TE Connectivity 社、APTIV 社 といった主要企業が一堂に会し、極めて競争力の高い最先端のイノベーションが披露された。

併催された『2026(第 4 回)国際自動車エレクトロニクス技術イノベーション・フォーラム』では、SoC チップ(CPU、メモリ、I/Oなどを一体化した高集積半導体)が車載 EEA



(Electrical/Electronic Architecture)を「中央演算+ゾーン制御」型へと進化させるメカニズムについて、詳細な分析が行われた。



一方、同じく併催された『2026 New Energy Vehicles Three Electric Technology Summit Forum』では、活発な議論が展開された。専門家らは、800V シリコンカーバイド電動ドライブの効率限界、高ニッケル電池および全固体電池の量産化に向けた転換点、さらには熱暴走時の安全管理といった業界の主要課題について、深く掘り下げた議論が交わされた。

認識力の飛躍:チップ性能がエンボディド・インテリジェンスの普及を加速

大規模モデルと膨大な計算能力という二つの

力に後押しされ、エンボディド・インテリジェンスは概念段階から実世界での応用へと急速に移行しつつある。こうした潮流を的確に捉えた今回の見本市において、「Embodied AI Industry Application Conference Embodied Intelligence Robotics Exhibition Area」は、多くの参加者を集め、新製品開発や今後の方向性に関する深い知見を提供した。

Texas Instruments 社、NXP Semiconductors 社、Melexis 社、Geehy 社、TDK 株式会社といった主要企業は、センサー、制御チップ、アクチュエータを中心とした極めて競争力の高いソリューションを披露し、エンボディド・インテリジェンスを多様なシナリオで実現するための強固なハードウェア基盤を提示した。

コンピューティングの相乗効果:AI ハードウェア・エコシステムの進化が半導体分野で加速

AI 技術の急速な進化とコンピューティング需要の指数関数的な増大は、半導体産業の基盤となるダイナミクスを大きく変容させつつある。今年の見本市では、Amphenol 社、Montage Technology 社、Dioo Microcircuits 社、Vicor 社などが多様な AI アプリケーション向けの最先端ソリューションを紹介し、半導体と AI の深い融合を一段と推進した。

見本市と併催された『Forum on Data Center Reconstruction and Edge Innovation Applications in the AI Era (AI 時代におけるデータセンター再構築とエッジ革新アプリケーションフォーラム)』では、新たなアーキテクチャやインメモリ計算技術が取り上げられ、大規模モデルが抱える演算上のボトルネックに正面から向き合った。

一方、『AI Empowerment, Intelligent Manufacturing Futures – AI Reshapes the New Ecosystem of Manufacturing Forum』(AI が製造業の新たなエコシステムを再構築する)』と題されたフォーラムでは、検査、予知保全、柔軟なスケジューリングにおける産業用大規模モデルの実装事例を通して、実務的なアプローチが紹介された。

スマートマニュファクチャリングの飛躍:産業用エレクトロニクス分野は自律協働の新時代へ
産業用エレクトロニクス分野は、現在、単純な自動化から自律型インテリジェンスへと移行しつつある。

Analog Devices 社、Fudan Microelectronics 社、Linearin 社、SG MICRO 社などの出展企業は、複雑化する産業シナリオに対応した最先端製品を披露し、新たな産業用エレクトロニクス・エコシステムの輪郭を示した。



併催フォーラム『Intelligent Connectivity, Co-evolution: Empowering Smart Factories with Next-Generation Flexible Technology(インテリジェント・コネクティビティと共進化:次世代フレキシブル技術によるスマートファクトリーの高度化)』では、インダストリー 4.0 の実践的な導入に向けた極めて有用なソリューションが提示された。

業界有識者が併催ハイレベルフォーラムで市場動向を示唆

今年の見本市に向けて精選された 15 本のテーマ別フォーラムは、自動車、AI、エンボディド・インテリジェンス、第 3 世代半導体、エネルギー貯蔵、脳・コンピュータ間インターフェースなどの最先端分野を網羅し、いずれも満席となった。また、世界各国から業界研究者、技術専門家、企業幹部が一堂に会し、生産プロセスの高度化や応用分野における新たな成果、さらには産業エコシステムの構築に至るまで、多角的な視点から産業動向を議論した。

三日間は瞬く間に過ぎ去ったが、エレクトロニクス産業における革新への取り組みは今後も続いていく。electronica Shanghai は、製品や技術を披露する場であるだけでなく、産業構造の変化を観察し、読み解くための窓口として機能し、革新的なアイデアと大規模な商業化を結び付ける重要なハブとしての役割を果たしている。

次回の electronica Shanghai は、来年、2027 年 4 月 14 日から 16 日まで、上海新国際見本市会場で開催の予定。

詳細情報ならびに写真は、専用ホームページまで:www.electronicachina.com.cn/en (英語)

資料請求、各種お問合せ先:メッセ・ミュンヘン 日本代表部

株式会社メッセ・ミュンヘン・ジャパン

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3 丁目 20-3 ノアーズアーク虎ノ門 5 階

Tel.: 03-6402-4583 Fax: 03-6402-4584 e-mail: info@messe-muenchen.jp

URL: www.messe-muenchen.jp (日本語) www.messe-muenchen.de (英語 / ドイツ語)